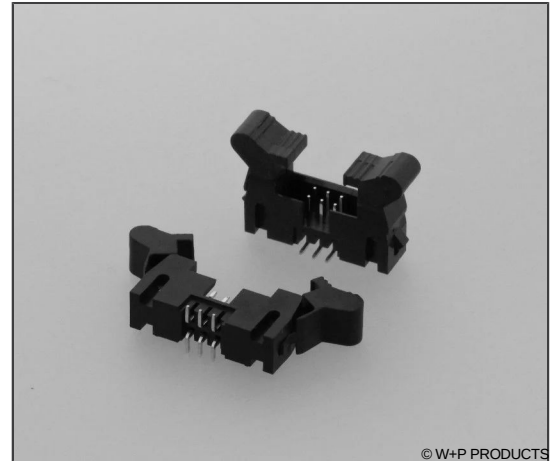


SMT-Wannenstiftleisten mit Verriegelung RM 2,00mm, stehend SMT Box Headers with Latches, 2.00mm Pitch, Vertical

Technische Daten / Technical Data

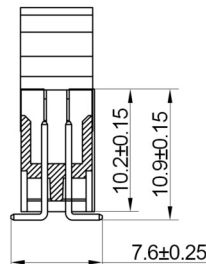
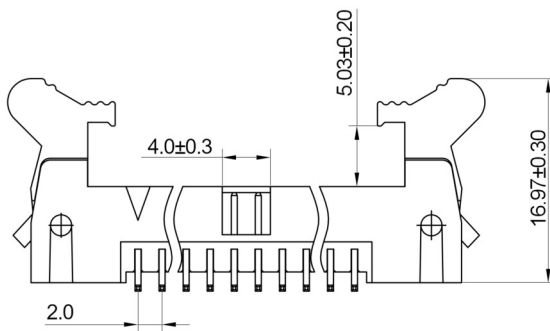
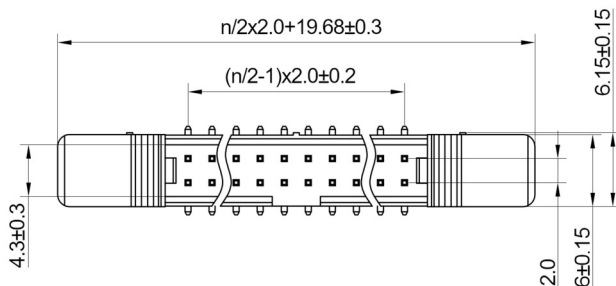
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung
Contact Material	Square pin 0.50mm, copper alloy
Kontaktoberfläche	Au flash über Ni
Contact Surface	Au flash over Ni
Durchgangswiderstand	20 mΩ max.
Contact Resistance	20 mΩ max.
Isolationswiderstand	500 MΩ min.
Insulation Resistance	500 MΩ min.
Spannungsfestigkeit	500 V AC/DC
Test Voltage	500 V AC/DC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden)
Processing	230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds)



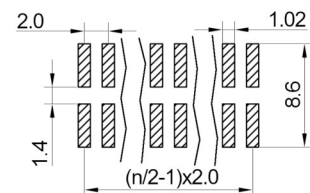
© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:

343



Recommended P.C.B Layout (Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)



Series

46-2380

Contacts *

40

06-40
Andere Kontaktzahlen auf Anfrage
Other numbers of contacts on request

Plating

00

00 Vergoldet
Gold plated

Packaging *

ST

ST
TRAY
PPST
PPTR (Option)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads

TRAY Im Tray / In Tray

PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads

PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	Lower Temperature [°C]
Duration above T_L	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

